



PANEL THERMOCHIP

PANEL THERMOCHIP	e total (mm)	RT (m2K/W)	U (W/m2K)	Peso (kg/m2)	Peso (kg/panel)	*3 apoyos L=1500	
						Carga max. (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)
TO/10-40_XPS 40mm	50,00	1,31	0,76	6,98	11,52	420,00	102,00
TO/10-50_XPS 50mm	60,00	1,62	0,62	7,30	12,05	446,00	107,00
TO/10-60_XPS 60mm	70,00	1,81	0,55	7,62	12,57	467,00	112,00
TO/10-80_XPS 80mm	90,00	2,39	0,42	8,26	13,63	488,00	119,00
TO/10-100_XPS 100mm	110,00	2,80	0,36	8,90	14,69	517,00	125,00
TO/10-120_XPS 120mm	130,00	3,53	0,28	9,54	15,74	545,00	132,00
TO/10-140_XPS 140mm	150,00	4,14	0,24	10,18	16,80	580,00	140,00
TO/10-160_XPS 160mm	170,00	4,67	0,21	10,82	17,85	>580,00	>140,00
TO/10-200_XPS 200mm	210,00	5,51	0,18	12,10	19,97	>580,00	>140,00

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tablero exterior - OSB3

Espesor	e (mm)	10
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,1
Densidad	D (kg/m3)	570
Difusión al vapor de agua	μ	90-150
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700

Núcleo aislante - XPS

Espesor	e (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	200
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,033	0,033	0,035	0,035	0,037	0,035	0,035	0,035	0,037
Densidad	D (kg/m3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Difusión al vapor de agua	μ	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1.450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450